



## 主要特点

隔离度: 50 dB @ 20 GHz

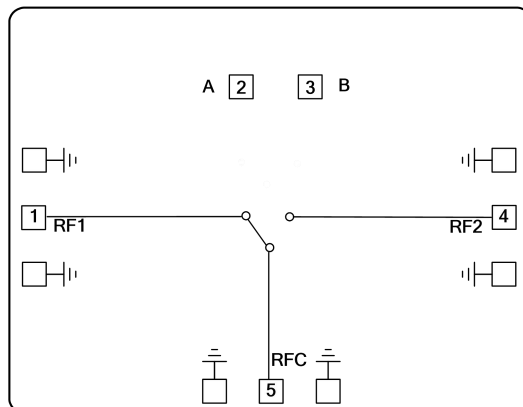
插入损耗: 1 dB @ 20 GHz

反射式设计

供电: -5/+5V@-16mA/23 mA

芯片尺寸: 1.9× 1.05× 0.08mm<sup>3</sup>

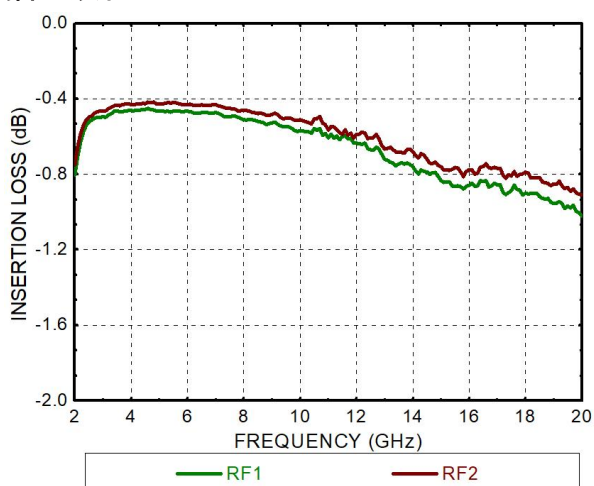
## 功能框图



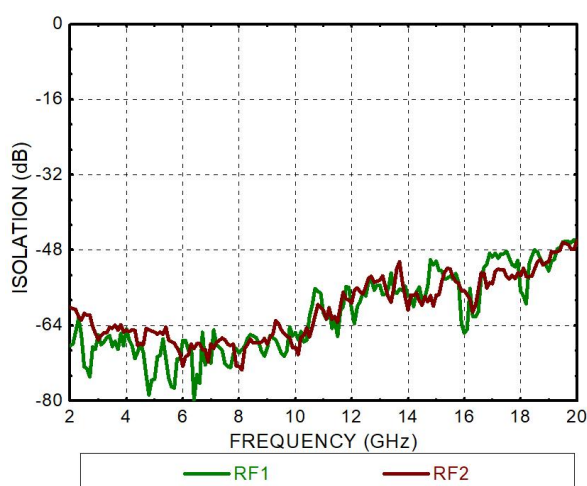
## 性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , $A/B = -5/+5\text{ V}$ )

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	2 - 20			GHz
插入损耗		0.8		dB
隔离度		50		dB
输入回波损耗		15		dB
输出回波损耗		15		dB
输入功率 1dB 压缩点@2-20GHz		26		dBm
开关切换时间		30		ns

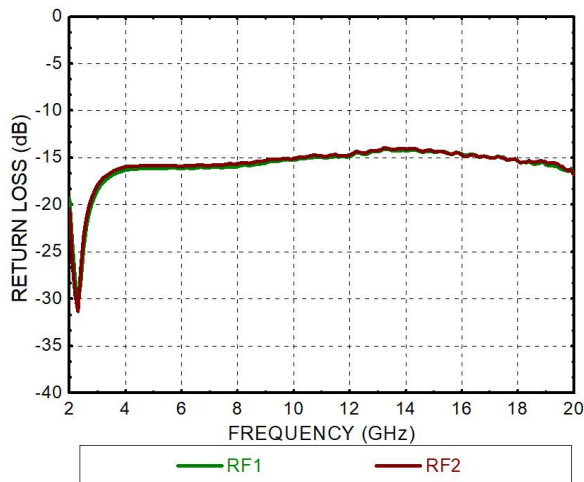
## 插入损耗



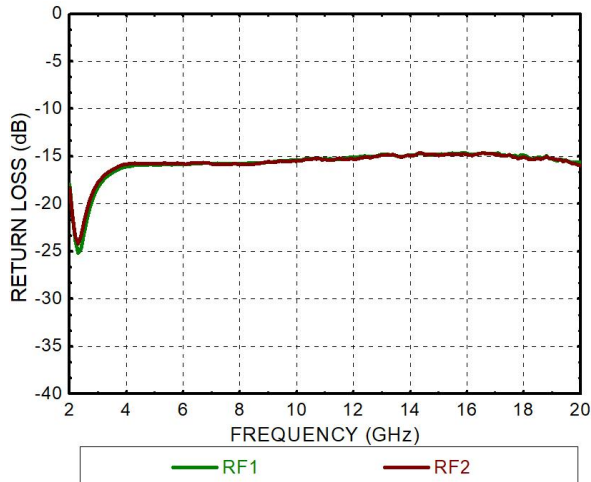
## 隔离度



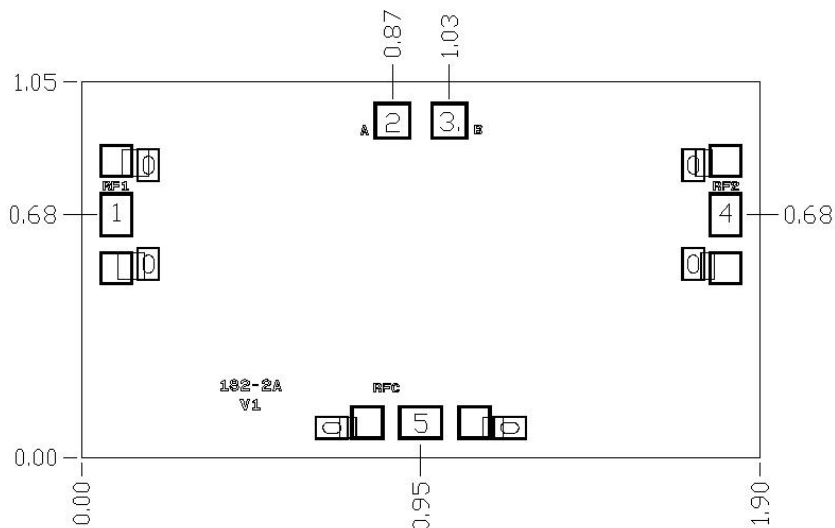
输入回波损耗



输出回波损耗



物理参数



焊盘描述

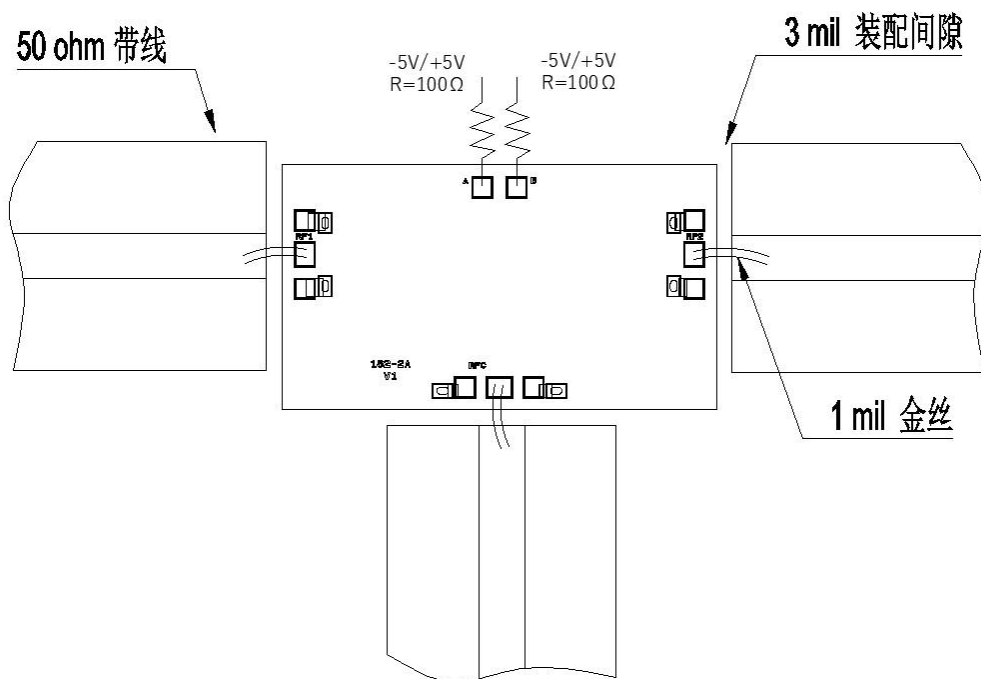
焊盘序号	功能	描述
5	RFC	该焊盘是信号输入焊盘, AC 耦合并匹配至 50 Ohm, 内部集成隔直电容
1,4	RF1, RF2	该焊盘是信号输出焊盘, AC 耦合并匹配至 50 Ohm, 内部集成隔直电容
2,3	A,B	该焊盘是信号控制焊盘, 接-5V / +5V 电压控制支路导通关断
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



## 真值表

A	B	RFC-RF1	RFC-RF2
-5V@-16mA	+5V@+23mA	导通	关断
+5V@+23mA	-5V@-16mA	关断	导通

## 推荐装配图



## 注意事项

1. 芯片厚度为 80  $\mu\text{m}$
2. 典型键合焊盘尺寸为  $110*90\mu\text{m}^2$
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接
7. 本产品采用空气桥工艺

## 极限参数

1. 电源电压: -6V, +6 V
2. 射频输入功率: +31dBm@6GHz
3. 储存温度: -65~+150°C
4. 工作温度: -55~+85°C